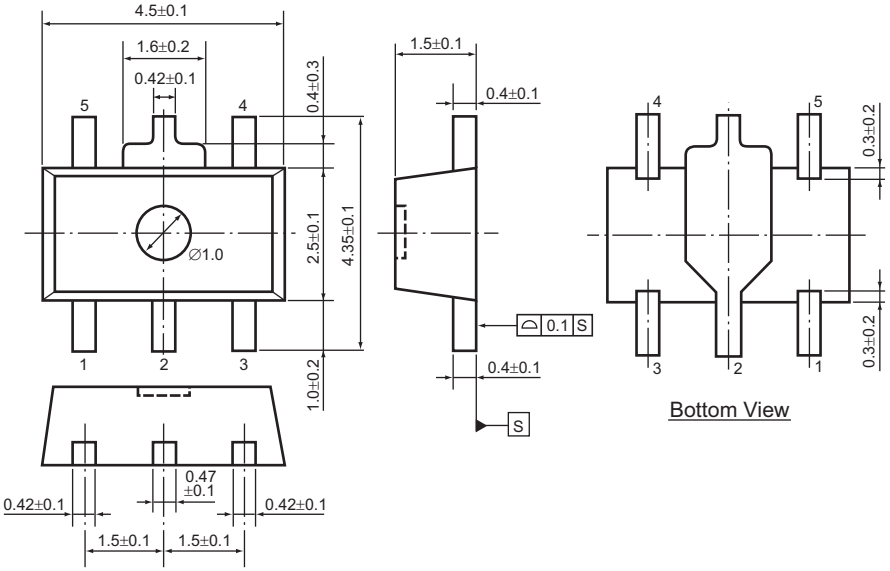
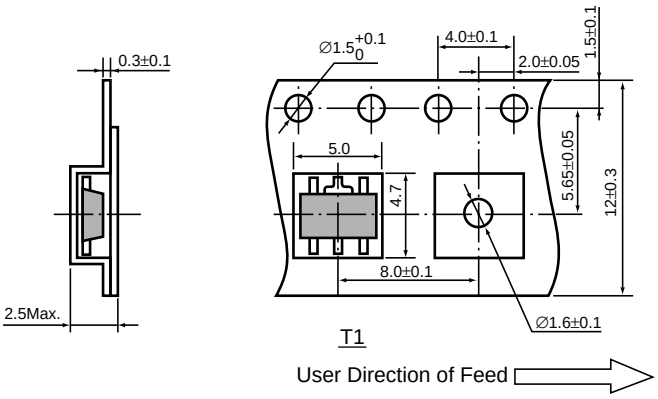
SOT-89-5

単位:mm

■ パッケージ外形図

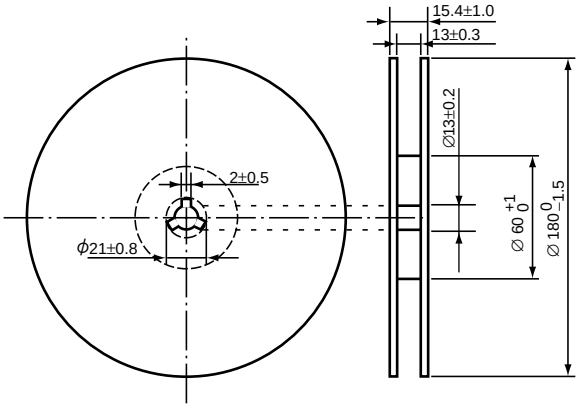


■ テーピング仕様



■ テーピングリール外形図　リユースリール(EIAJ-RRM-12Bc)

(1リール＝1,000個)



■ 許容損失について（SOT-89-5）

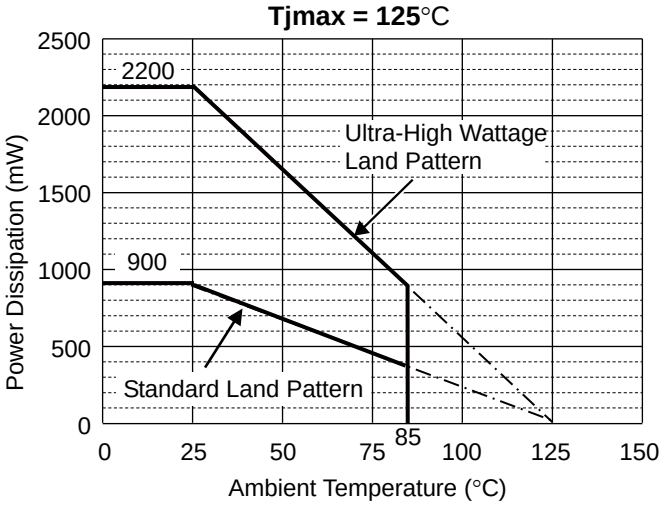
SOT-89-5パッケージの許容損失について特性例を示します。
なお、許容損失は実装条件に左右されますので、本特性例は下記測定条件での参考データとなります。

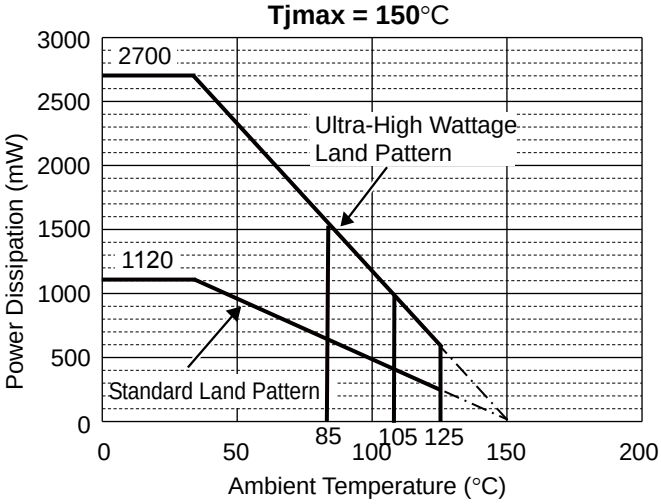
測定条件

	標準実装条件	超ハイワッテージ実装条件
測定状態	基板実装状態（風速 0m/s）	基板実装状態（風速 0m/s）
基板材質	ガラスエポキシ樹脂（両面基板）	ガラスエポキシ樹脂（両面基板）
基板サイズ	50 mm × 50 mm × 1.6 mm	76.2 mm × 114.3 mm × 0.8 mm
配線率	表面　約 10%、裏面　約 100%	外層（1 層、4 層）：約 96%、50 mm 角 内層（2 層、3 層）：約 100%、50 mm 角
スルーホール	ー	直径 0.3 mm×28 個

測定結果（Ta=25°C）

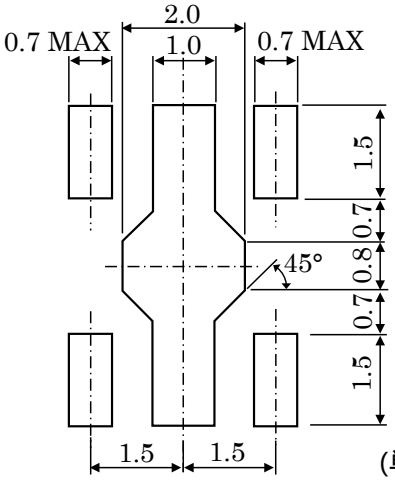
	標準実装条件	超ハイワッテージ実装条件
許容損失	900 mW（Tjmax = 125°C） 1120 mW（Tjmax = 150°C）	2200 mW（Tjmax = 125°C） 2700 mW（Tjmax = 150°C）
熱抵抗値	θja = 111°C/W	θja = 46°C/W θjc = 16°C/W



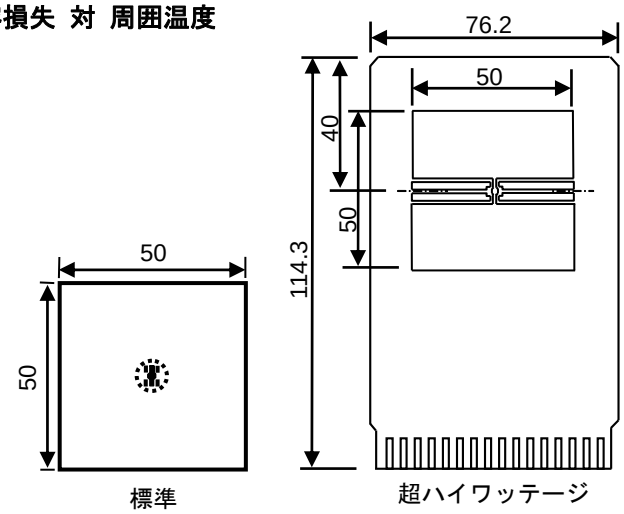


許容損失 対 周囲温度

■ 基板パッド推奨寸法



(単位：mm)



IC 実装位置（単位：mm）
測定用基板レイアウト